****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com [www.congatec.com](http://www.congatec.com)  | info@sams-network.com [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com)  |



*Christian Eder von congatec war an dem Entwurf der SMARC 2.0 Spezifikation maßgeblich beteiligt*

*Text und Foto verfügbar:* [*http://www.congatec.com/presse*](http://www.congatec.com/presse)

Pressemitteilung

**congatec unterstützt SMARC 2.0 Spezifikation vollumfänglich**

**SMARC 2.0: Eine komplementäre Lösung**

**Perfekt zwischen Qseven und COM Express positioniert**

**Deggendorf, 30. Juni 2016 \* \* \*** congatec – ein führender Technologie-Anbieter für Embedded Computermodule, Single Board Computer (SBCs) und Embedded Design & Manufacturing (EDM) Services – gibt bekannt, die neue SMARC 2.0 Spezifikation, die vor wenigen Tagen von der [Standardization Group for Embedded Technologies e.V.](https://www.facebook.com/SGET.eV/) (SGET) verabschiedet wurde, vollumfänglich zu unterstützen. Diese wichtige Technologie-Adaption erweitert congatecs führendes und umfassendes Computer-on-Module Portfolio um ein brandneues Lösungsangebot, das sich perfekt zwischen Qseven und COM Express positioniert. Erste congatec SMARC 2.0 Module sowie Carrierboards und Starterkits inklusive umfassendem Software-, Treiber- und BIOS-Support werden im August verfügbar.

congatecs Support des Standards ist für Insider keine Überraschung, denn congatec hat sich innerhalb der SGET maßgeblich an der Entwicklung der SMARC 2.0 Spezifikation beteiligt, die einen neuen Meilenstein in der Embedded Computer-on-Module Technologie markiert und speziell für multimedia-orientierte und IoT-angebundene kleine Systeme ausgelegt ist.

Christian Eder, Director Marketing von congatec, Vorstandsmitglied der SGET und Editor der SMARC 2.0 Spezifikation zur Bedeutung der neuen Spezifikation: „Mit der Revision 2.0 hat SMARC nun ein hervorragendes Qualitätsniveau erreicht, welches wir unseren Kunden vorbehaltlos empfehlen können. Bekannte Schwachstellen der Vorgängerversionen – wie beispielsweise der zu beliebige Alternate Function Block – wurden beseitigt, was Kunden den Einstieg in die SMARC Technologie erleichtert und die Langzeitverfügbarkeit sicherstellt. SMARC 2.0 bietet damit die perfekten Voraussetzungen, ein sehr erfolgreicher neuer Modul-Standard zu werden und signifikante Marktanteile zu generieren.“

„Mit congatec als Draft Editor der neuen Spezifikation konnten wir die entscheidenden Verbesserungen dieser neuen Spezifikation maßgeblich vorantreiben“, erklärt Jason Carlson, CEO der congatec AG. „Als Marktführer für Computer-on-Module in EMEA haben wir unser Wissen und unsere Markterfahrung eingebracht, um SMARC 2.0 als eine Spezifikation zu positionieren, die die Anforderungen des Marktes über viele Jahre hinweg erfüllen wird. Wir sehen SMARC 2.0 als komplementäre Ergänzung unseres bisherigen Qseven und COM Express Angebots. Durch den Support aller drei Plattformen werden wir ein noch breiteres Produktspektrum haben, mit dem wir die sich erweiternden Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen können.“

SMARC 2.0 bietet zahlreiche moderne serielle IOs sowie IoT-, Netzwerk- und Video-Schnittstellen und ist damit für viele multimedia- und grafikorientierte IoT-Applikationen prädestiniert. SMARC positioniert sich damit perfekt zwischen dem robusten, ultra-low-Power Standard Qseven für tief eingebettete Systeme und dem featurereichen COM Express Standard für besonders leistungsstarke Embedded-Designs, die bis zu Edge- und Fog Servern reichen.

**Die technischen Highlights von SMARC 2.0**

Mit dem großen Schritt von SMARC 1.1 auf 2.0 hat SMARC eine klare eigenständige Positionierung im etablierten COM-Markt erhalten. Über die 314 Pins des MXM 3.0-Konnektors werden zahlreiche Multimedia-Interfaces ausgeführt, sodass SMARC 2.0 eine starke Multimedia-Orientierung mit bis zu vier Videoausgängen bietet. Ausgeführt werden 2x 24 Bit LVDS / eDP / MIPI DSI zuzüglich HDMI/DP++ und DP++. Hinzu kommen zudem 2x MIPI Kamerainterfaces sowie zwei Audioschnittstellen über HDA und I2S. Neu hinzugekommen sind auch zusätzliche USB-Ports für nun bis zu 6x USB inklusive 2x USB 3.0, ein zweiter Ethernet-Port für eine vertikale IoT-Vernetzung, eine vierte PCI Express Lane und 1x eSPI. Dafür entfielen unter anderem die obsoleten parallelen Kamera- und Display-Interfaces, der Alternative-Function-Block, externes eMMC, SPDIF und einer der drei I2S-Kanäle.

**Über die congatec AG**

Mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland ist die congatec AG ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren Qseven, COM Express, XTX und ETX, sowie für Single Board Computer und EDM-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliche Kernkompetenz und technisches Know-How sind besondere, erweiterte BIOS Features sowie umfangreiche Treiberunterstützung und Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec unterhält Niederlassungen in Taiwan, Japan, China, USA, Australien und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de/) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*